

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2026-007

债券代码：123252

债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

关于拟注册发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，优化负债结构，银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据（科技创新债券）的议案》，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，拟以银邦金属复合材料股份有限公司为发行主体，发行额度预计不超过4亿元的中期票据（科技创新债券）。本次注册发行中期票据事项尚需提交公司股东会批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、本次注册中期票据额度的目的

1. 发行中期票据（科技创新债券）有利于拓宽公司融资渠道，有效降低融资风险，使公司负债结构更加合理。

2. 发行中期票据（科技创新债券）有利于提升公司行业地位和知名度，为公司打下良好的信用基础，对公司形象提升具有积极的意义。

二、本次中期票据的发行预案

1. 注册和发行规模：本次拟注册中期票据（科技创新债券）的规模不超过4亿元，在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行中期票据（科技创新债券）。

2. 发行期限：本次拟注册和发行中期票据（科技创新债券）的期限为不超过3年。

3. 发行利率：发行中期票据（科技创新债券）的利率根据市场情况确定。

4. 计算类型：固定利率

5. 募集资金用途：包括但不限于补充流动资金、偿还债务以及交易商协会认可的其他用途。

6. 决议有效期限：本次发行中期票据（科技创新债券）事宜经公司股东会批准后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

三、本次注册发行中期票据的授权事项

为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东会授权公司董事会办理本次发行具体事宜，包括但不限于：

1. 确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、发行时机等具体发行方案；

2. 聘请本次发行的承销商及其他中介机构；

3. 在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据（科技创新债券）的相关申报、注册手续；

4. 如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5. 办理与本次中期票据（科技创新债券）发行相关的其它事宜；

6. 上述授权在本次发行的中期票据（科技创新债券）的注册及存续有效期内持续有效。

本次发行中期票据事项能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2026年3月12日